TOSHIBA

# 車載用パワー半導体

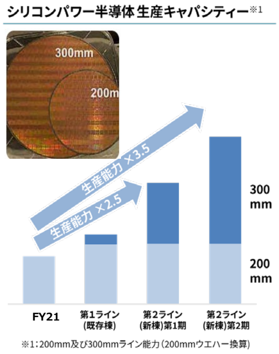
Power Semiconductors for Automotive

## カーボンニュートラルな未来の実現にむけた環境車市場に対応

Point 1

## Si 300mmラインの量産稼働開始

- 市場が拡大するパワー半導体の安定供給のため2022年下期から加賀東芝エレクトロニクス(株)で量産稼働開始
- MOSFETやIGBTを中心に製品を展開



Point 2

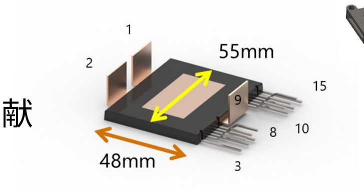
## SiC製品を車載用途へ展開予定

- 東芝グループで培ってきた技術・資産(鉄道向け高耐圧SiCで培ったノウハウ)を活かし車載用途へ最適な製品開発

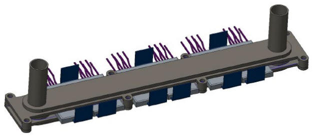
Point 3

## xEVトラクションインバーター向け両面放熱パッケージを開発中

- インバーターの高パワー密度化に貢献する高放熱パッケージを開発中
- RC-IGBTを内蔵しインバーターの小型化に貢献 (SiC MOSET搭載も検討中)




●パッケージイメージ



●冷却システム提案

東芝デバイス&ストレージ株式会社